

低应力导热灌封材料逆变器有机硅灌封胶 8230 - 1

产品名称	低应力导热灌封材料逆变器有机硅灌封胶 8230 - 1
公司名称	上海拜高高分子材料有限公司
价格	200.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路155弄5号（注册地址）
联系电话	021-67227200 18121160382

产品详情

产品特性及用途:

Besil 8230 A/B 是一种双组分有机硅导热灌封胶，经混合后具有很好的流动性，操作时间可根据温度调整，室温可深层固化,适用各种散热耐温元件的灌封保护，完全符合欧盟ROHS指令以及SVHC REACH要求。

基本性能

双组分加成型硅橡胶

⋄1 : 1混合比例

低硬化收缩率

优异的高温电绝缘性、稳性定

良好的防水防潮性

优异的阻燃性 UL No : E340199

应用领域

汽车电子、模块

LED电源驱动模组

太阳能组件接线盒

电动车充电桩模块

锂电池组、电容组

磁感线圈

逆变电源

硬化前特性

测试项目

测试标准

A组分

B组分

外观

目测

白or黑色粘稠液体

白色粘稠液体

粘度,cps , 25

GB/T 10247-2008

3500±500

比重,g/cm³, 25

GB/T 15223-1994

1.55±0.05

混合比

质量比

A : B = 100 : 100

混合后粘度,cps , 25

GB/T 10247-2008

混合后操作时间

60 \pm 10

硬化条件

25 /4 hr或80 / 30mins

固化后特性

硬化物外观

白色or灰黑色弹性体

硬度, Shore A

GB/T 531-2008

55 \pm 5

导热系数 , W/mK

GB/T 10297-1998

0.80

线性膨胀系数 , K⁻¹ , ppm

HGT 2625-1994

300

介电强度,kV/mm, 25

GB/T 1695-2005

\geq 20

体积电阻,DC 500V , $\Omega \cdot \text{CM}$

GB/T 1692-92

1.1 \times 10¹⁵

损耗因素(1 MHz)

GB/T 1693-2007

0.009

介电常数(1 MHz)

3.00

温度范围,

GBT 20028-2005

- 60 200

耐燃性

UL-94

V-0

PS: 操作时间及固化时间是以配胶量100g来测试的。
固化状态所有数据都在25℃、55%RH条件下胶固化7天后测定所得。

操作使用说明

1、施胶之前将A、B组分在各自包装中搅拌均匀，这是因为胶料在贮存过程中，其中的填料可能会部分沉降。

2、将A、B组分按1：1的比例称量，混合均匀，直接注入需灌封保护的元器件（或模块）中。顺着器壁的一边慢慢注入，可减少气泡的产生。

3、将灌封好的元件静置，让其自行排泡，气泡基本消失后可加温固化，亦可直接在室温条件下固化，大约需要4hr。

4、需要定量灌胶的灌封设备请咨询我公司市场部。

注意事项

1、对混合后A/B组分真空脱泡可提高硬化产品性能

2、A、B组分取用后应密封保存

3、温度过低会导致固化速度偏慢，温度过高会导致固化速度偏快，建议车间恒温

4、BeSil 8230与含硫、胺、有机锡、不饱和烃类增塑剂等材料接触会难以硬化，常见物质有松香、天然橡胶，使用前须先测试。

包装规格

Besil 8230W白色有机硅导热灌封胶

A组分：10 kg/塑料桶

B组分：10kg/塑料桶

Besil 8230黑色有机硅导热灌封胶

储存及运输

本产品需在35℃以下的阴凉干燥环境中贮存，在25℃以下贮存期为1年。

此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输，小心在运输过程中泄漏。

超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。

贮存过程中可能产生少许沉降分层，搅拌均匀后使用不影响性能。